

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

公告编号：2023-061

## 天津凯华绝缘材料股份有限公司

### 关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日接待了1家机构的调研，现将主要情况公告如下：

#### 一、 调研情况

调研时间：2023年8月25日

调研地点：公司二楼会议室

调研形式：现场调研

调研机构：东北证券股份有限公司

上市公司接待人员：董事长任志成先生、总经理任开阔先生、董事会秘书兼财务负责人郝艳艳女士、证券代表刘舒瑶女士

#### 二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题一：公司业务介绍。

凯华材料是一家电子材料生产型企业，主要产品是环氧粉末包封料和环氧塑封料两款产品，环氧粉末包封料占比较大，约占90%。环氧粉末包封料主要应用于下游的电阻电容，包括陶瓷电容、压敏电阻等器件，环氧塑封料主要应用于半导体封装以及部分陶瓷电容等器件的贴片化（贴片的分离器件）。公司在产业链的位置大概是上游为化工材料、添加剂材料等材料制造商，下游为电子元件制造商和半导体器件制造商，再下游是电子品牌等消费电子端、车载配件组件商、通信端等，公司处在比较上游的位置，产品下游应用到最终市场分布较广，大部分应用分布在消费电子，小部分在汽车、通讯、新能源领域。目前公司人员规模

140 多人。公司成立于 2000 年，去年 12 月在北交所上市。

问题二：环氧粉末包封料和环氧塑封料下游应用的区别。

下游客户群不同，都叫电子元器件或电容，但是应用的规格和产品不同。环氧粉末包封料主要应用于单层陶瓷电容类，如压敏电阻；环氧塑封料的应用涉及到集成电路和分离器件的电容。

问题三：公司产品分为几大类，如快速固化、高温固化、耐高温，有何区别。

快速固化产品是工艺配置不同，为了适应客户快速固化产线的要求。比如客户原先的产线是分段式的，产品有热固化的过程，产线较长时对于快速固化没有要求，但新的产线是自动化的，要求公司的产品在有限时间内完成固化，对材料有快速固化的要求，因此对材料进行了配方和生产工艺的改进。耐高温产品是由于区别于原先的产品开发时对温度的需求，对温度要求更高，形成了新的产品分类。

问题四：下游消费电子和工业电子方面的应用。

消费电子方面主要应用于家用电器和手机的配套电源。工业电子方面主要应用于汽车、通讯、电力配套设备、部分新能源方面。目前了解到客户的产品应用到新能源车领域主要在附属设备，如充电桩。公司产品主要供给电子元器件的制造商。公司的业务方向不完全围绕一个行业做设计，有的时候会围绕行业拓展材料，有的时候是围绕材料去拓展业务，会充分考虑。

问题五：国内外销售占比情况。

国内销售占比约 90%，直接出口销售占比约 10%。大部分客户是外资企业，有的外资企业客户会同时有境内和境外工厂，境内工厂的订单算境内销售，境外的订单算境外销售，计算大客户销售收入的时候会合并计算。

问题六：原材料成本波动情况及对公司的影响。

原材料价格今年整体回落，国产环氧树脂成本有所降低，硅微粉稍微降低了一些。环氧树脂在原材料中占比最大，目前国内产能不是特别过剩，前几年有供应不足的情况。公司原材料采购是根据库存管理情况，结合市场行情进行，相对稳定，不会做特别大量的储备。

原材料上涨对公司的影响不是很直接，会比较滞后。公司和客户议价分为两种，一种是以部分指标作为依据进行浮动调价，另一种长期合作的会倾向于采用

稳定单价、年度议价的方式，毛利率如果过低的时候就会启动价格谈判。

问题七：市场规模及市场份额情况。

根据中国电子元件行业协会出具的《关于电子元件用环氧粉末包封料全球市场格局的说明》，2021年全球电子元件用环氧粉末包封料的市场规模为10.56亿元，公司在2021年电子元件用环氧粉末包封料全球市场主要参与者的销售数据统计中市场占有率为12.03%。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2023年8月28日